

苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，根据业务及日常经营需要，公司及子公司拟向相关银行申请综合授信额度，现将具体情况公告如下：

一、公司及子公司拟申请综合授信的基本情况

为满足公司及子公司经营发展需要，更好地支持业务的拓展，保证战略的实施，公司及子公司拟向银行申请以下综合授信额度：

（1）公司拟向中国光大银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度；

（2）公司拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度；

（3）公司及全资子公司安徽宇邦新型材料有限公司拟向中信银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币 25,000 万元的综合授信额度。

上述拟申请授信额度尚需银行最终审批，且拟申请授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额将视公司及子公司安徽宇邦新型材料有限公司（以下简称“安徽宇邦”）运营资金的实际需求确定，在授权额度内以银行与公司、安徽宇邦实际发生的融资金额为准。上述融资方式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、贸易融资、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等，融资期限以实际签署的合同为准。

二、业务授权

在公司董事会批准上述授信额度事项的前提下，公司董事会授权以下事项：

1、在授权期限内，上述授信额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满的授信额度不再占用额度，并授权公司董事长全权签署上述额度内有关的法律文件；

2、根据实际经营需要，具体调整、调剂公司的授信额度；

3、授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。

三、备查文件

公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 27 日